(9日本国特許庁

⑩特許出願公開

公開特許公報

昭53-48956

庁内整理番号 62日本分類 50Int. Cl.2 識別記号 7516-39 12 B 221 B 23 K 1/00 6735 - 4210 D 16 B 23 K 35/22 7516-39 12 B 23 C 22 C 21/00

砂公開 昭和53年(1978)5月2日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈皮材中のSiの芯材中への拡散を抑制するア ルミニウム合金ブレージング・シート

名古屋市港区千年三丁目1番12 号 住友軽金属工業株式会社内

住友軽金属工業株式会社 他出

東京都千代田区丸の内1丁目4

番4号

人 弁理士 福田保夫 何代 理

昭51-124565 20特 願

②出

昭51(1976)10月18日 願

杉山禎彦 70発 明 者

:明

1. 発明の名称

皮材中の81の芯材中への拡散を抑制するア ルミニウム合金ブレージング・シート

2. 特許請求の範囲

+ アルミニウム又はアルミニウム合金からな る芯材上に主合金元素の一つとして81を含 むアルミニウム合金を皮材として設けたプレ ージング・シートにおいて、ろう付け工程に おいて前記皮材中の81が芯材中へ拡散する のを抑制するために、前記芯材に 0.65~1.8 wtめの範囲内にBiを含ませたことを特徴 とするアルミニウム合金プレージング・シー ١o

3. 発明の詳細な説明

本発明はアルミニウム又はその合金からなる プレージング・シートに関し、詳しくは皮材 中のB1が芯材中へ拡散しがたいプレージン ク・シートに関する。

アルミニウム又はその合金を用いた特に複雑

*1*6 2

た模造物のろう付けには、 アルミニウム又は その合金からなる芯材上に、ろう材 (一般に A1-6~12 \$81合金) を皮材として設 けたいわゆるプレージング・シートが用いら れている。

そして、ろう付け方法にはフラックスを用い たトーチろう付け・炉中ろう付け・浸液ろう 付けの他、フラックスを用いない真空ろう付 け、不活性ガス雰囲気ろう付けなど多くの方 法がある。

ろう付けは、A1ー81合金ろう(816~ 13 %程度) を用いた場合、一般に 6 1 0 ℃ 前後の温度で行われるが、 浸漬ろう付では溶 融フラックス浴中に構造物を浸漬する前に、 ろう材の固相温度以下の比較的高温で長時間 の予熱が必要であり、また通常の炉中ろう付 でもとくに大型構造物では、しばしばろう付 前の予熱が行なわれる。

このように予熱が行なわれる場合には、皮材 中の81が芯材(一般にAA3003合金、

AA6951合金など)中へ拡散して、皮材中のS1の不足を来し、その結果、接合不良を生じる。この傾向は予熱条件が厳しいほど、またプレージング・シートが薄いほど著しく、条件によつては(断面を顕微鏡で観察すると)皮材中の初品S1粒が全く認められない程顕著なことがある。このような状態ではもちろん皮材に、ろう材としての役割を期待することはできない。

また、ろう付け前に予熱が行われない場合に も、例えばフィン材にプレーシング・シート を用いた場合には板厚が非常に薄いので、ろ う付け時の 6 1 の拡散に基く欠陥(例えば、 構造物の自重や治具の重さにより、ろう付け 時にフィンが座屈し、その結果ろう付け後の 寸法が所定の範囲に入らない)が発生するこ とがある。

皮材中の81が芯材へ拡散した状況を予熱前 と予熱後とを対比して図面により説明すると、 第1図は予熱前のプレージング・シート断面

Na 5

じたものであり、その程度は皮材や芯材の化学成分、皮材や芯材の厚さ、初晶 S 1 粒の形状や大きさ、加熱条件などによつて異なる。本発明は叙上の欠陥を防止するため、芯材中に各種の元素を添加することにより皮材中のS1が芯材中へ拡散するのを抑制する目的で行つた研究の結果に基えものであり、その特徴とするところは従来のプレージング・シート用芯材合金に0.65~1.6 w t その範囲内にS1を含ませた芯材合金よりなるプレージング・シートにある。

Biが0.65wt 多未満では皮材中のBiの 芯材への拡散を抑制する効果がなく、また1.8 w t 象を超えると芯材の融点が低くなり、ろ う付時に芯材が溶融するので芯材としての役 割を期待できない。

なお、ととていう芯材合金とは一般に A 1 - M n 系の3003合金、A 1 - M g - S 1 系の6951合金であるが、もちろん芯材合金はこれらに限定されず、芯材として用いられ

のミクロ組織を模式的に示したものであり、 第2四はプレージング・シートを皮材の固相 温度(A1-B1合金では577℃)以下の 比較的高温(例えば560℃)で長時間(例 えば7時間)加熱したあとの断面のミクロ組 総を模式的に示したものである。

これらの図で、1 は皮材(A 1 - B i 合金、他に 0 u、 2 n などを含んでもよい)、 2 は芯材、 3 は皮材中の初晶 B i 粒、 4 は芯材と皮材の境界を示す。境界 4 は点線で示されているが、芯材 2 と皮材 3 は熱間圧接によつて冶金的に接合されているので、実際には点線で示されるほど明確でないことはいうまでも

ところで、第1図のプレージング・シートを高温で長時間加熱すると、第2図の5で示したように、皮材中に境界4からある幅をもつて初品81粒が誠められない領域5が形成される。これは高温・長時間の加熱によつて皮材中の81が芯材中へ拡散するととにより生

16,6

得る純アルミあるいはその合金をも含む。
一方、皮材は基本的にはA1-81系合金
(通常816~13wt9程度、例えばAA
4043、4045合金など)であるが、皮材はこれらに限定されず、A1-81系合金
に種々の目的、例えば融点を下げるため、漏れ性の改善のため、あるいは真空並びに雰囲
気ろう付を可能にするために2n、Cu、Mg、B1、Beなどの元素が単独あるいは複合して添加された合金も含んでいることはいうまでもない。

本発明になるプレージング・シートを素材とした大型の構造物はろう付け前に高温長時間の予熱を行つても満足なろう付け継手が得られ、また本発明になるプレージング・シートを高温長時間の予熱を要しないような板厚が非常に薄いフィン材などのろう付け構造物に用いても満足な継手が得られた。

とれは本発明によるプレージング・シートを 案材とした構造物では、ろり付前の予熱時に 皮材中の81の芯材への拡散が有効に抑制されたこと、また予熱を必要あるいは必要としないいずれのろう付においても、ろう付温度に加熱された時に、溶融ろうの芯材への拡散が抑制されたことによるためである。

以下に本発明になるプレージング・シートおよび従来の3003合金を芯材として用いたプレージング・シートについて、高温長時間加熱後のSi拡散状況を実施例で示す。

奥 施 例 1

それぞれ純アルミ及びこれに19の81を添加した合金を芯材とし、それぞれA1-75

\$81及びA1-12 \$81合金を皮材としたフレーシング・シート(板厚2mm、皮率8

***、芯材の結晶粒度30~36 #)を560

***に対いた30 mm があった。

はついて81の拡散状況を顕微鏡にて観察したところ、第1表の結果が得られた。

16,9

学2表、高温原的国内经验aTL-ジップ:十aSia标散状况

	120	A IMITALLY (AV (4)	VV(UU) / L . / / / / / / / / / / / / / / / / /	A74-112
本	材	皮 材	初品 S 1 粒の存在している層の厚さ (加熱後) 皮材の厚さ (加熱前) ×100 (多)	
			560C×10hr加熱後	560℃×20hr加熱後
300	3合金	A1-7.5%Si	6 0	4 0
(S 1 0.3 %)		A1-12%81	7 5	70
3003合金+81		A1-7.5%81	7 2	70
		A1-12%61	9 1	8 5
3003合金+81		A1-7.5%81	7 8	7 1
(811	.25%)	A1-12%S1	9 1	8 3

: 上表より芯材中に1 多及び1.2 5 多 B 1 を含ませると、B 1 を含まない芯材を用いた場合

第1表 高温長時間加熱後のプレージング・シートの81の拡散状況

芯材	皮材		初晶81粒の存在している層の呼さ (加熱後) 皮材の厚さ (加熱前)	
			560C×10hr加熱後	560℃×20nr加效後
	A1-7.5%	81	7 5	7 1
純アル	A1-12%	81	8 7	8 2
	A1-7.5%	S 1	9 2	8 7
A1-1%6	A1-12%	81	9 6	9 5

上表より芯材中に19S1を含ませた場合、 放意に81を含ませない芯材を用いたものが としてがである。でではないです。 著しく抑制されることが明らかである。また との効果は皮材中のS1量が多いほど大きい。 次に加熱前あるいは加熱後の本発明になるブ レージング・シートを通常のろう付温度即ち 580~620℃に10~15分加熱して、 そのミクロ組織を調べたところ、芯材の溶融 は全く認められなかつた。

実 施 例 2

それぞれ3003合金(Al-1.2多Mn、 81畳0.3多)及びAl-1.2多Mn合金に

Na 1 0

に比べて、皮材中の81の芯材への拡散が著しく抑制されることが明らかである。また、この効果は皮材中の81畳が多いほど大きい。 次に加熱前あるいは加熱後の本発明になるプレージング・シートを通常のろう付温度即ち580~620℃に10~15分加熱してそのミクロ組織を調べたところ、芯材の裕融は全く認められなかつた。

4. 図面の簡単な説明

第1図は予熱前プレージング・シートの断面 のミクロ組織を模式的に示した図。 第2図は予熱後プレージング・シートの断面 のミクロ組織を模式的に示した図。

济出领人 住友轻金荷工業株式会社

代理人 福田保夫

